



**平成21年3月期(第7期)
第2四半期決算説明会**

**平成20年11月6日
株式会社ジーダット**

1. 上期 (第2四半期累計期間) 決算概要と通期の見通し

2. トピックス

3. 今後の方向性

上期(第2四半期累計期間)および通期のポイント

上期は当初計画通りの業績(売上高前年比35%増)

通期も当初計画通りの見通し

積極的な研究開発投資を継続

海外販売体制の強化を継続

上期(第2四半期累計期間)業績概要(連結)

(単位：百万円)

	第2四半期累計期間 前年同期比				平成21年3月期 Q1、Q2業績				通期比			
	平成20年3月期		平成21年3月期		Q1業績		Q2業績		平成20年3月期業績		平成21年3月期計画	
	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	計画	売上高比
売上高	914	100.0%	1,234	100.0%	731	100.0%	502	100.0%	2,136	100.0%	2,260	100.0%
売上総利益	619	67.8%	909	73.7%	567	77.6%	341	67.9%	1,478	69.2%	1,561	69.1%
販売費及び一般管理費	594	65.0%	613	49.7%	284	38.9%	329	65.5%	1,256	58.8%	1,276	56.5%
営業利益	25	2.8%	295	23.9%	283	38.7%	12	2.4%	221	10.4%	285	12.6%
経常利益	71	7.8%	322	26.1%	303	41.5%	18	3.7%	294	13.8%	310	13.7%
当期純利益	46	5.1%	215	17.5%	193	26.4%	22	4.5%	197	9.2%	200	8.8%

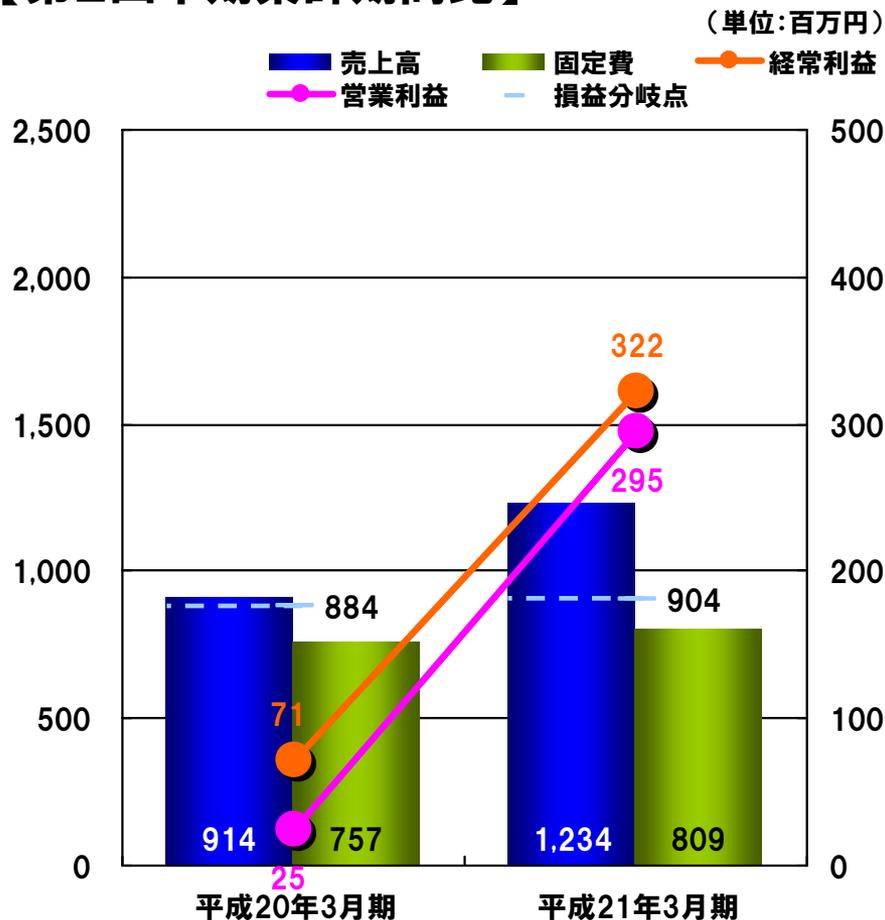
事業別売上高の推移（連結）

（単位：百万円）

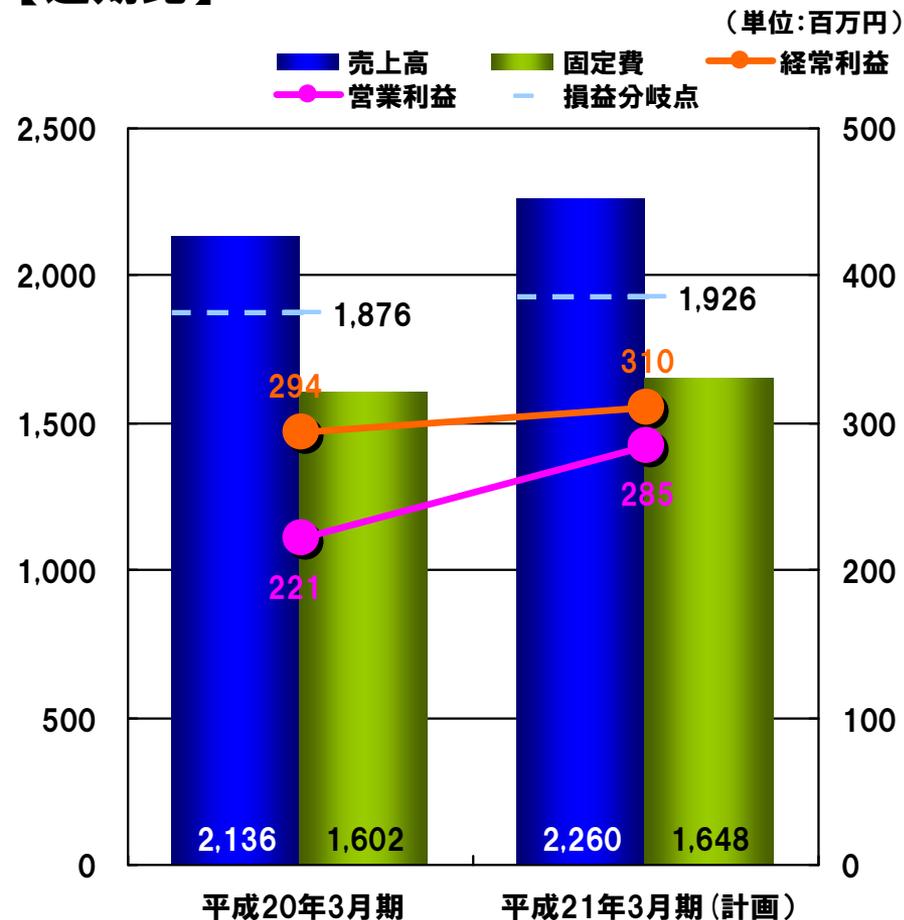
	第2四半期累計期間 前年同期比				平成21年3月期 Q1、Q2業績				通期比			
	平成20年3月期		平成21年3月期		Q1業績		Q2業績		平成20年3月期業績		平成21年3月期計画	
	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	実績	売上高比	計画	売上高比
半導体市場	573	62.7%	845	68.5%	549	75.0%	296	58.9%	1,479	69.2%	1,480	65.5%
FPD市場	340	37.2%	388	31.4%	182	24.9%	206	41.0%	656	30.7%	780	34.5%
自社開発製品	783	85.7%	1,111	90.0%	670	91.5%	441	87.8%	1,834	85.8%	2,015	89.2%
代理販売製品	130	14.2%	122	9.9%	61	8.3%	61	12.1%	301	14.1%	244	10.8%
製品	485	53.1%	772	62.5%	504	68.9%	267	53.1%	1,236	57.9%	1,330	58.8%
サービス	428	46.8%	462	37.4%	227	31.0%	235	46.8%	900	42.1%	930	41.2%

売上・利益の推移

【第2四半期累計期間比】



【通期比】

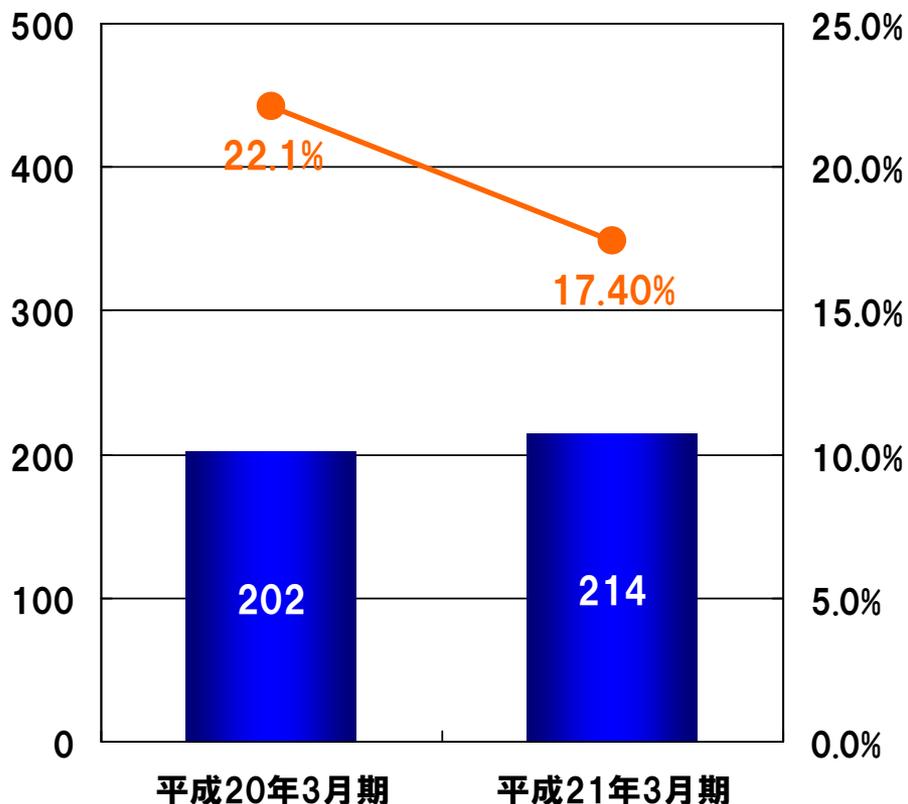


研究開発費の推移

【第2四半期累計期間比】

(単位:百万円)

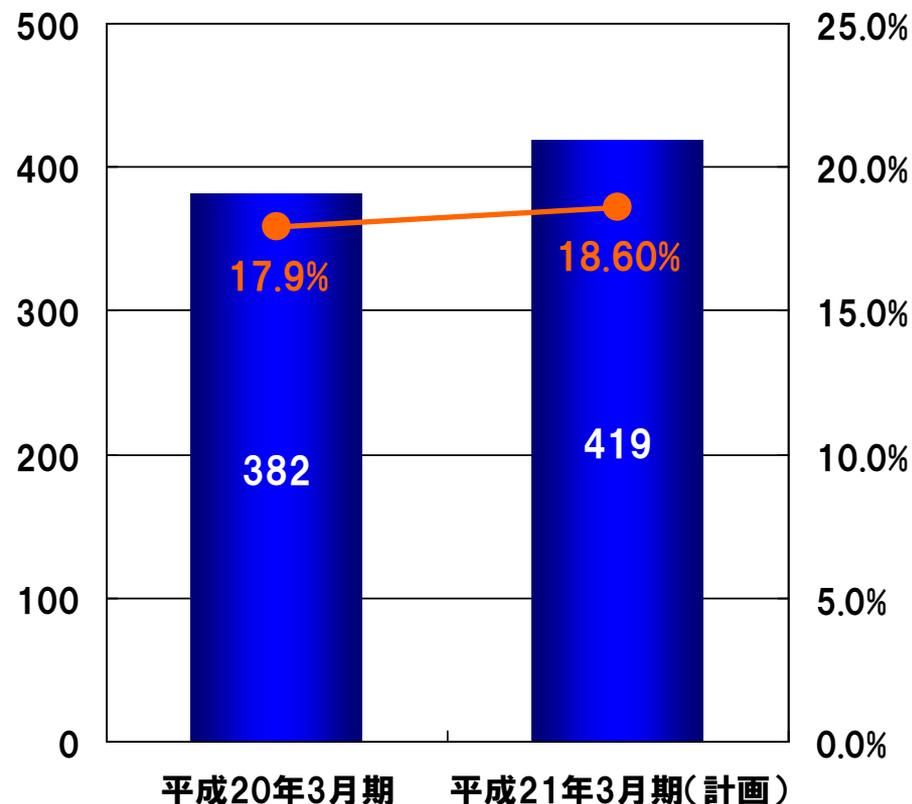
■ 研究開発費 ● 売上高比



【通期比】

(単位:百万円)

■ 研究開発費 ● 売上高比

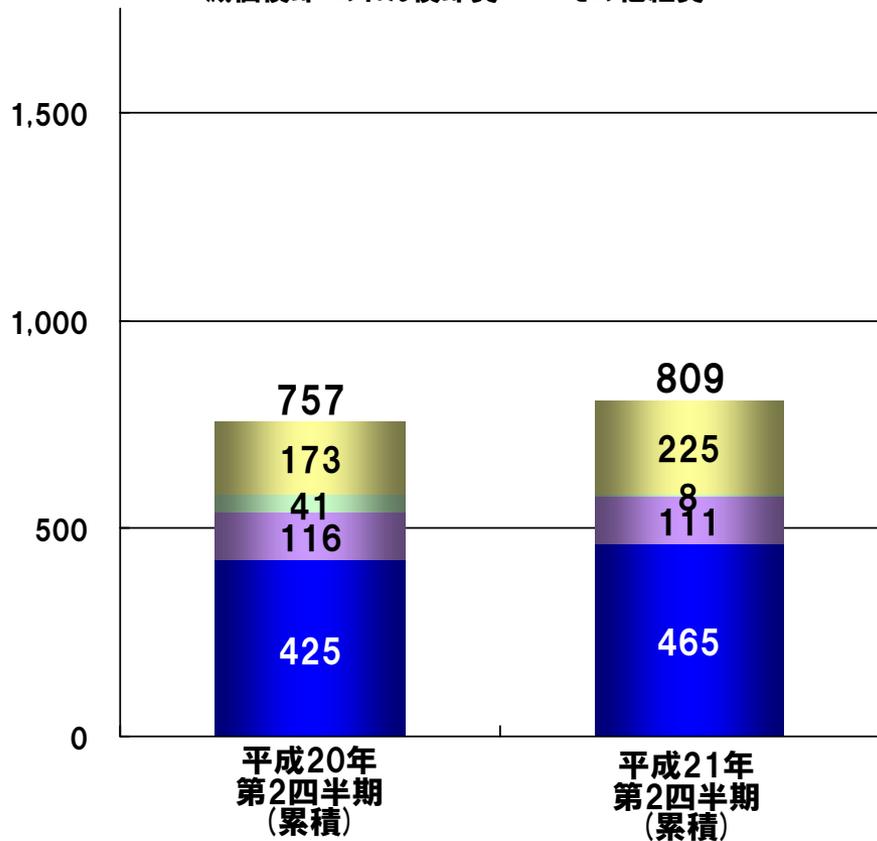


固定費内訳推移（連結）

【第2四半期累計期間比】

（単位：百万円）

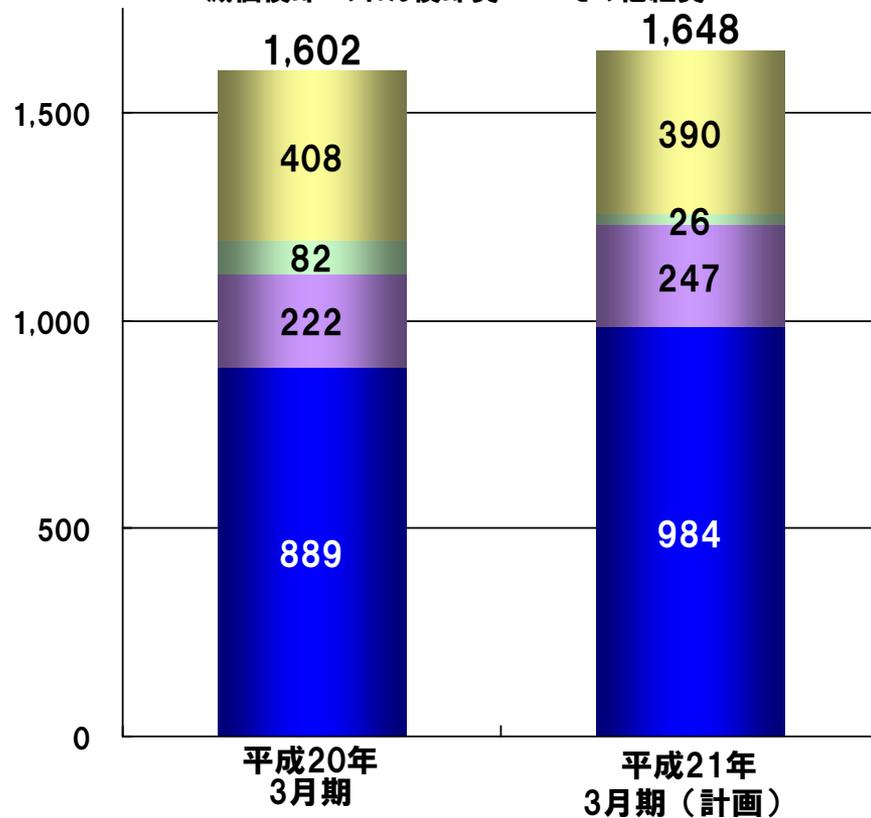
- 人件費
- 外注費
- 減価償却・のれん償却費
- その他経費



【通期比】

（単位：百万円）

- 人件費
- 外注費
- 減価償却・のれん償却費
- その他経費



連結貸借対照表

(単位:百万円)

	平成20年 3月31日	平成20年 9月30日	差異		平成20年 3月31日	平成20年 9月30日	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	1,894	1,832	△61	I 流動負債	561	670	109
1 現金及び預金	1,348	1,368	20	1 買掛金	148	90	△57
2 受取手形及び売掛金	421	342	△78	2 未払法人税等	115	123	8
3 たな卸資産	27	11	△16	3 賞与引当金	87	86	△1
4 繰延税金資産	56	57	0	4 その他	209	369	160
5 その他	45	56	10	負債合計	561	670	109
6 貸倒引当金	△4	△3	1	(純資産の部)			
II 固定資産	1,076	1,428	351	I 株主資本	2,428	2,606	177
1 有形固定資産	24	25	0	1 資本金	760	760	-
2 無形固定資産	8	44	36	2 資本剰余金	890	890	-
3 投資その他の資産合計	1,043	1,358	314	3 利益剰余金	810	988	177
(1) 投資有価証券	100	103	3	4 自己株式	△32	△32	-
(2) 長期貸付金	5	4	△1	II 評価・換算差額等	△19	△16	2
(3) 繰延税金資産	181	194	12	その他有価証券評価差額金	△21	△18	3
(4) 長期預金	700	1,000	300	為替換算調整勘定	2	2	△0
(5) その他	55	55	△0	純資産合計	2,409	2,590	180
資産合計	2,970	3,260	289	負債純資産合計	2,970	3,260	289

連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

	平成19年4月1日 ～ 平成19年9月30日	平成20年4月1日 ～ 平成20年9月30日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	76	408	331
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 827	△348	478
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29	△38	△ 9
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△0	△1
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△778	20	799
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,917	1,348	△569
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,138	1,368	230

1. 上期（第2四半期累計期間）決算概要と通期の見通し
2. **トピックス**
3. 今後の方向性

トピックス

- **主力商品: α-SX V3.3.0をリリース(8月)**
 - 主に回路・レイアウト連携機能およびFPD設計機能を強化
- **有機ELパネル設計用2次元光学シミュレータの販売開始(10月)**
 - 有機ELパネル設計システムの強化
- **スタンダードセルライブラリ検証ツールの販売開始(10月)**
 - ライブラリ作成・検証機能の強化
- **プライベートショウを大阪・東京で開催(10月)**
 - 新製品を多数紹介
 - ユーザによるジーダット製品の運用事例紹介
- **NECエレクトロニクス向けプロセス・デザイン・キットの配布開始(11月)**
 - オープン性拡大の一環
- **中国SMIC向けプロセス・デザイン・キットの配布開始(11月)**
 - オープン性拡大の一環



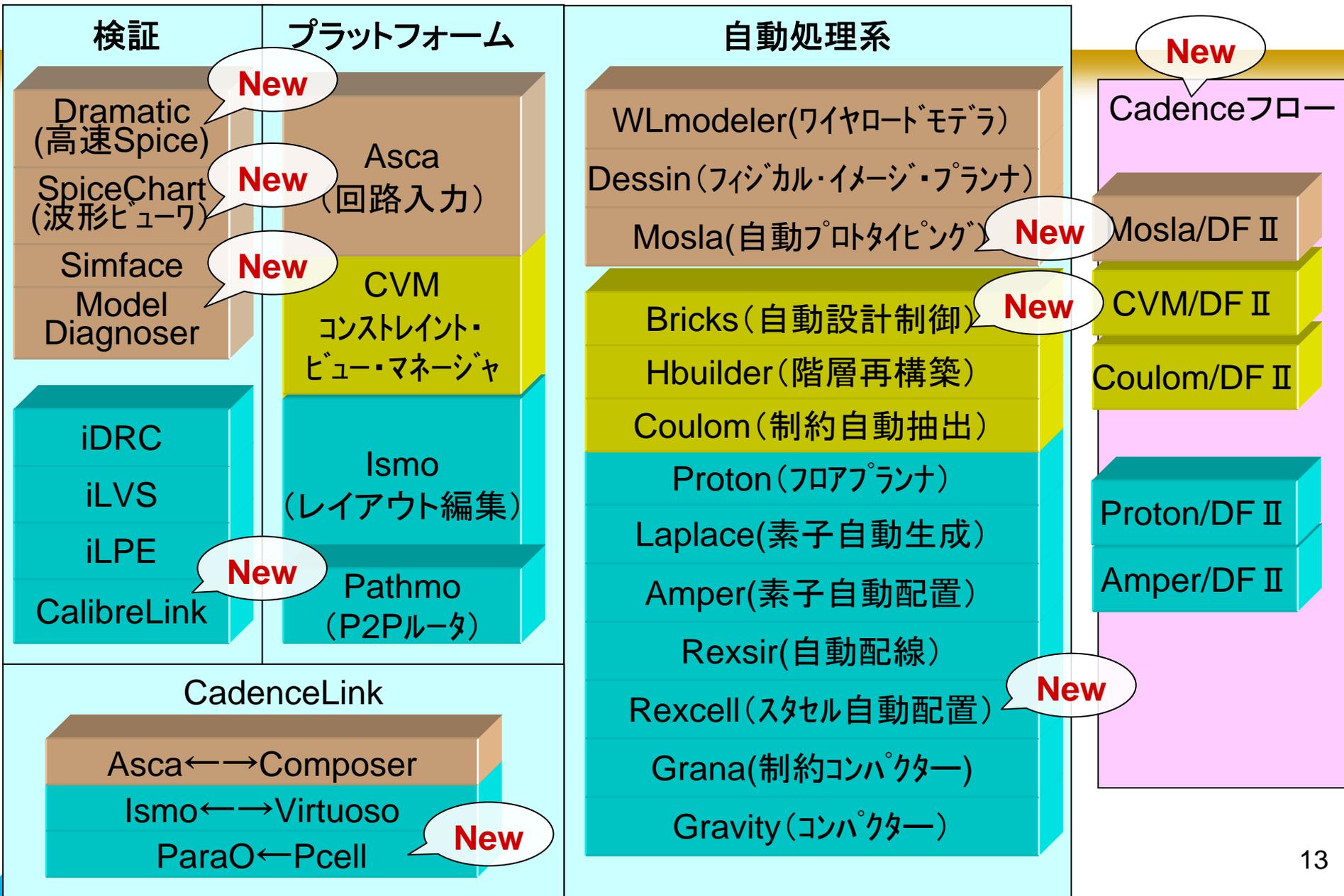
ユーザによる当社製品運用事例の紹介

日経BP社TechOn! EDAサイトに紹介記事の掲載

「アナログ・チップでも回路再利用率70%」、トヨタテクニカルディベロップメントとジーダットが新EDAシステムを構築（2008/10/19 23:46）

「設計期間の半減が見えた」、東芝マイクロがアナログ・レイアウトEDAをジーダットの「 α -SX」に1本化（2008/10/20 22:02）

新製品の紹介(半導体設計向け)



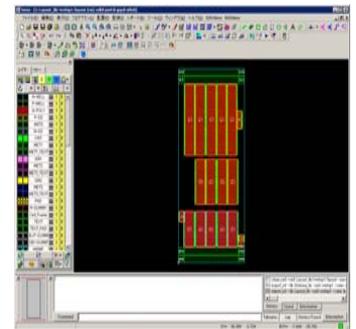
主な新製品(半導体設計向け)

● Dramatic <開発コード>(高速Spiceシミュレータ)

- 特長:アナログ回路向け高速シミュレータ。従来製品に対して実行速度が10~50倍で精度は同等を実現。
- 販売目標:3億円(3年間)
- リリース時期:2009年初旬

● Mosla (アナログブロック自動プロトタイピング)

- 特長:回路設計者向けのレイアウト見積りツール。設計の早い段階でサイズの見積りや品質の作り込みを行うことができる。
- 販売目標:1.5億円(3年間)
- リリース時期:2009年初旬



新製品の紹介(FPD設計向け)

検証

Dramatic(高速Spice)
 SpiceChart(波形解析)
 SimfaceLCD(光、回路Sim制御)
 ExpertLCD(液晶3D光Sim)
 ExpertOLED(有機EL2D光Sim)

iDRC

iLVS

iLPE

CalibreLink

FineERC(ERC検証)

FineLVL(LVL検証)

FineAcres(抵抗計算)

FineQap(容量抽出)

PradiseWorld2(断面表示)

New

New

New

New

New

New

プラットフォーム

Asca
 (回路入力)

Ismo
 (レイアウト編集)

Pathmo
 (P2Pルータ)

FineArts
 (微細パターン設計用
 パッケージ)

New

New

New

フロアプラン・ 自動処理系

WLModeler
 (ワイヤロードモデラ)

Laplace
 (素子自動生成)

FineCFC
 (CF自動生成)

FineFPC
 (IC-FPC間配置配線)

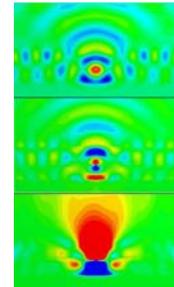
FineGFP
 (ガラスフロアプランナ)

FineRFP
 (レチクルフロアプランナ)

主な新製品(FPD設計向け)

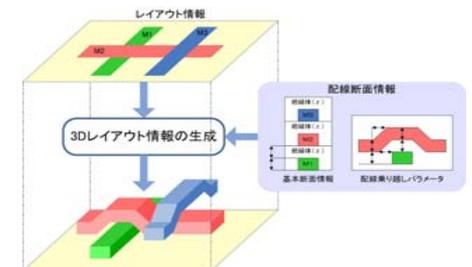
● ExpertOLED (有機ELパネル向け2次元光学シミュレータ)

- 特長: 従来の1次元に対して、2次元のシミュレーションを実現することにより、有機ELパネルの発光状態を精度良く解析できるようになった。そのため、試作コストや設計時間の大幅な削減を実現。
- 販売目標: 1億円(3年間)
- リリース時期: 2008年10月



● FineQap (大型液晶パネル向け3次元容量抽出)

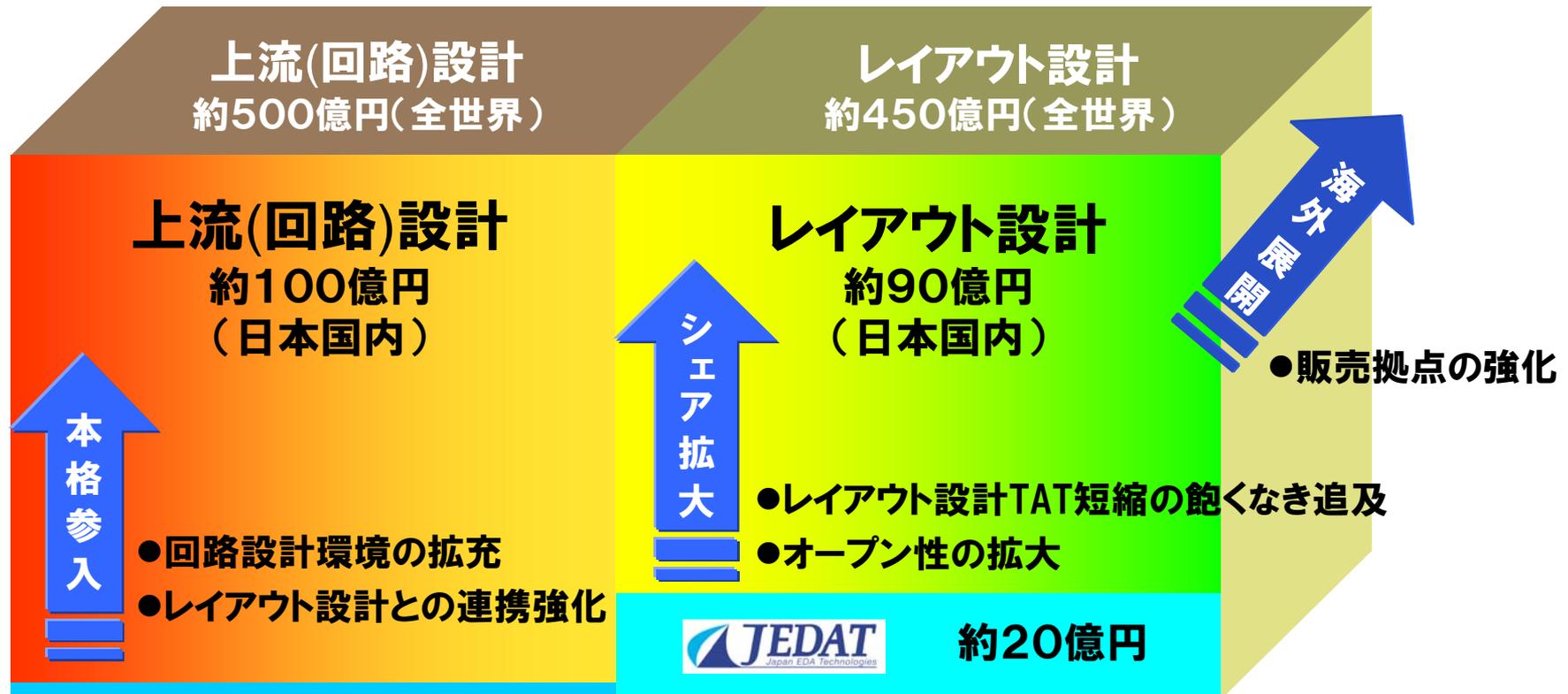
- 特長: 液晶パネル向けの高精度・高速な容量抽出ツール。従来は液晶パネル向けの同等製品が無かったため、パネルの配線容量を精度良く予測できなかった。近年パネルの表示高速化により、容量予測の精度が重要になってきた。その解決策として有効なツールである。
- 販売目標: 1.5億円(3年間)
- リリース時期: 2009年初旬



1. 上期（第2四半期累計期間）決算概要と通期の見通し
2. トピックス
3. 今後の方向性

カスタム設計分野の市場規模※と拡大戦略

- 強みを伸ばす: レイアウト設計分野におけるシェア拡大
- 強みを活かす: 上流設計分野への本格参入、海外市場への展開



※市場規模は、当社が各種統計情報から算出した製品売上高の推定値です。 18

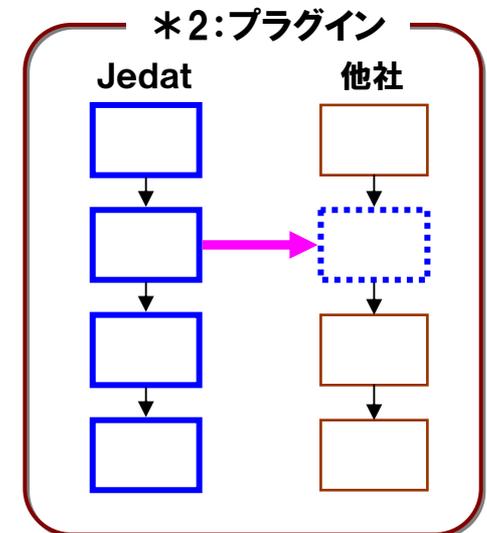
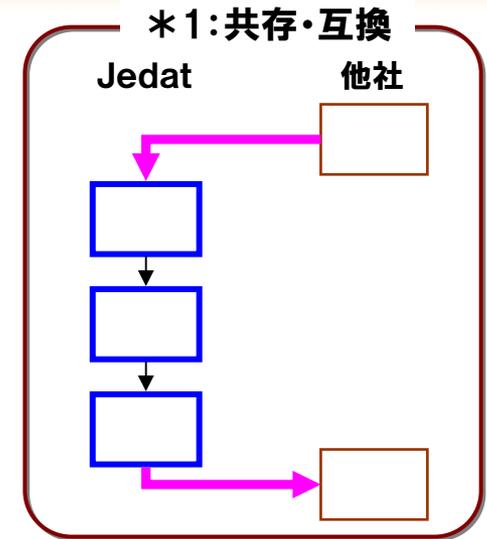
シェアの拡大(レイアウト設計分野)

● レイアウト設計TAT短縮の飽くなき追及

- 自動設計エンジンは実用レベル
- 使い方及び使い易さを徹底的に追求

● オープン性の拡大

- 業界標準団体に加盟
- 他社接続プログラムに加入
- 他社設計フローとの共存・互換*1
- 設計ツールを他社設計フローに接続(プラグイン)*2



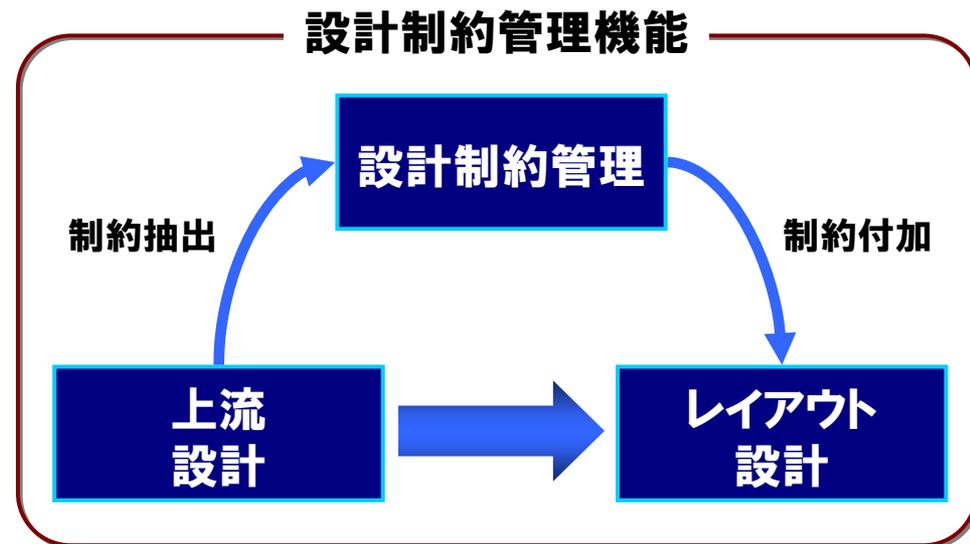
本格参入(上流設計分野)

● シミュレーション環境の拡充

- 新製品: 高速Spiceシミュレータ(Dramatic)の投入
- 新製品: Spice波形解析ツールの開発

● レイアウト設計との連携強化

- 上流設計とレイアウト設計の融合
- 設計制約管理機能の強化



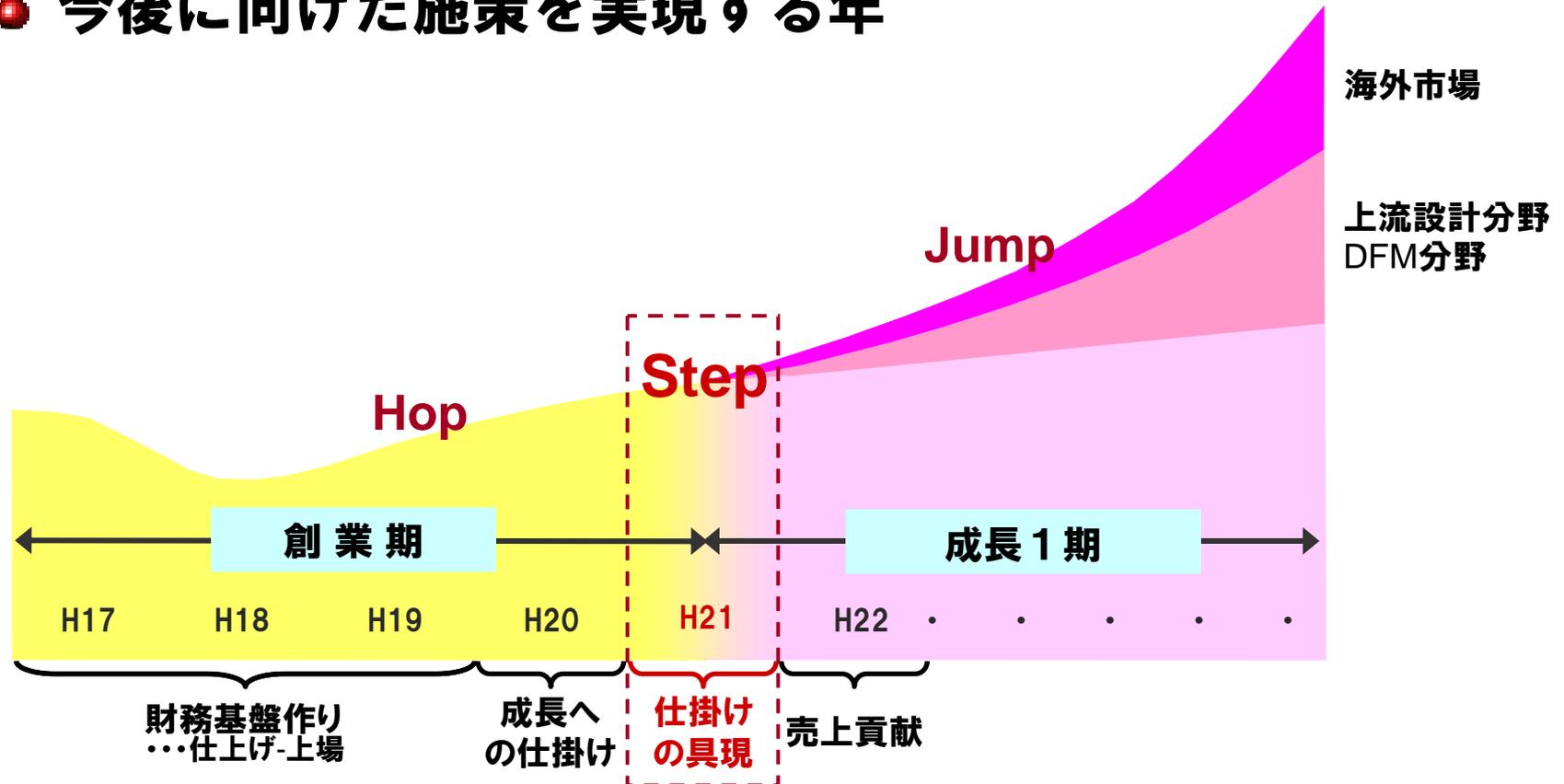
海外展開

- 台湾の代理店強化
- 中国拠点に販売支援機能を付加
- 欧州に販売代理店を設置



平成21年3月期の位置づけ

- 創業期から成長期への転換点（「Step」の位置付け）
- 今後に向けた施策を実現する年



ご清聴有難うございました